

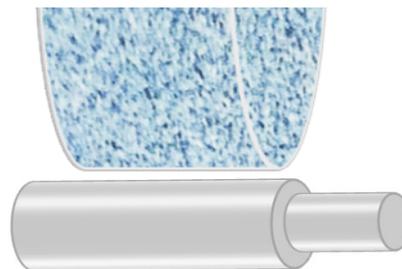
TB bond

セラミック砥石用高強度ボンド

シャフト

円筒研削

■製品/加エイメージ



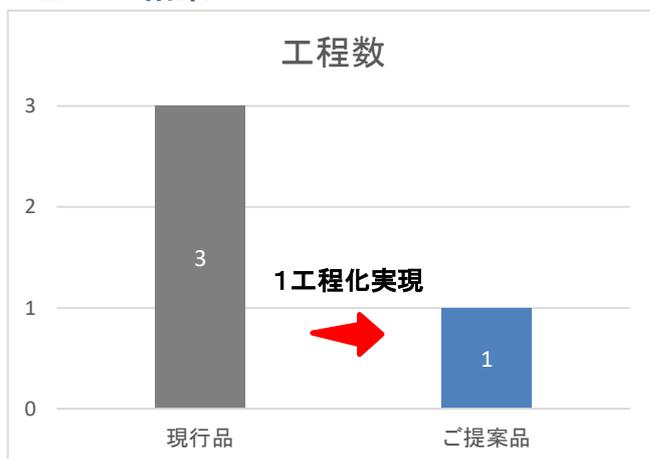
■砥石仕様

形状 / 寸法 / 周速	平型	405	×	38	×	127	34 m/s
現行品	セラミック砥粒	80		J	8	V	---
ご提案品	M5W	60		K	8	V	TB

■研削条件

研削盤 / 方式	円筒研削	/	プランジ
加工物 / 寸法	金属部品	/	Φ10～Φ100mm
被削材 / 硬度	SKD11	/	---
取り代 / 面粗度	---	/	---
ドレス理由	スクラッチ発生	/	研削焼け

■加工結果



- ・スクラッチ発生を抑制
- ・研削焼けの発生を抑制
- ・1工程化を実現